

'85 국내외 한국과학기술자 학술회의 추계 Workshop을 다녀와서

이 주 성⁺

한국과학기술단체에 총연합회 주최로 '85년 국내외 한국과학기술자 학술회의 추계 Workshop으로 금속표면처리, 반도체 및 조선기술분과가 개최되었다. 이중 금속표면처리기술분과는 신흥도시로 도시계획이 잘된 경남 찬원의 한국기계연구소에서 지난 10월 16일, 17일 2일간 열렸었다. 분과위원장으로 한국기계연구소의 이해 소장과 본인이 맡아 반년 이상 여러가지 계획을 맡았었으나 대과없이 유익한 Workshop으로 끝맺을 수 있어 매우 다행스럽게 생각되었다.

특히 이번 금속표면처리기술분과에는 전식도금과 습식도금의 두 분야로 나누어 진행되었다.

전식 및 습식분야의 발표가 도합 12건으로 해외

에서는 전식분야에 서독 Braunschweig 공대 교수인 이경종 박사와 미국의 General Electric Co의 정철규 박사의 발표가 있었으며 습식분야는 미국 IBM Corp의 정대영 박사와 일본 동해대학의 장감순 교수의 발표가 있었다.

발표자와 발표제목 및 토론자의 명단은 다음과 같았으며 상당히 열기있는 질의가 있어 시간가는 줄도 보를 정도였으며 만 2일간 화기애애한 분위기 하에서 헤어지는 아쉬움을 남기고 참원을 떠났다.

본 Workshop의 논문집이 본 한국금속표면공학회에 1부 비치되어 있으므로 참고하실 회원은 연락 바랍니다.



*본회 회장

발표자 및 발표제목

(전식도금분야)	좌장 : 백 영 험 (고려대)	(습식도금분야)	좌장 : 이 주 성 (한양대)
The fundamentals of CVD and PVD	전 철 규 (미국 General Electric Co.)	1) Evolution of microstructure during Electroless copper (미국 IBM corp.) deposition	
이온 (ion) plating 방법을 이용 한 금속표면의 알미늄 피막처리에 관한 연구	박 봉 석 (대한항공)	2) Mechanisms of electroless metal Plating : mixd potential theory and the interdependence of partial reactions	
Thin film deposition by dry methods	박 봉 구 (서울대)	구리와 니켈 전착층의 집합조직, 이동성 단면조직, 표면현상 및 기계적 성질 (서울대)	
Plasma를 이용한 금속의 표면처리	이 경 총 (서독 Braunschweig 대)	The effect of flow rate on the microstructure of zinc electrodeposits	예 길 촌 (영남대)
transmission electron microscopy and X-ray diffraction studies on reactively sputtered Ti-N films	이 성 래 (고려대)	Observation of crystal surface atoms by FEM and FIM-build-up structure of W, Fe cathode with Si adsorption	장 갑 순 (일본동해대)
이온질화의 특성과 이온질화 처리강의 마멸에 관한 연구	조 규 식 (공사)	Sn-Ni 합금 도금에 관한 연구	박 광 자 (국립공업시험원)
		펄스 전착크롬 도금층의 물성연구	권 식 철 (한국기계연구소)

토 론 자

학 계	강 탁 (서 울 대) 여 운 관 (홍 익 대) 윤 병 하 (경 북 대) 윤 승 열 (한 양 대) 이 상 래 (부 산 대) 천 성 순 (과 학 원)	이 규 화 (기계연구소) 정 형 식 ("") 김 선 규 (기아산업, 중앙연구소) 김 건 상 ("") 최 성 우 (금성사, 중앙연구소) 이 주 완 (대한중석) 한 홍 택 (현대전자) 황 학 빈 (한일공업) 여 인 배 ("")
연 구 소 및 산 업 체	전 의 진 (기계연구소) 서 상 기 ("") 권 영 배 ("")	